

2024年3月期 第1四半期 決算説明資料



日本高純度化学株式会社

証券コード：4973

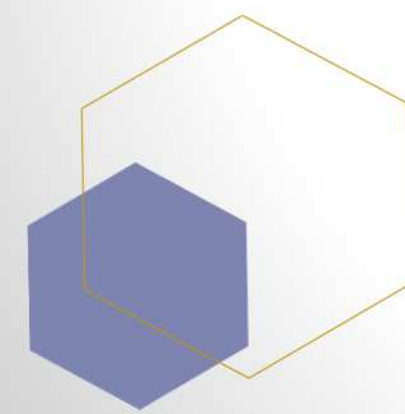
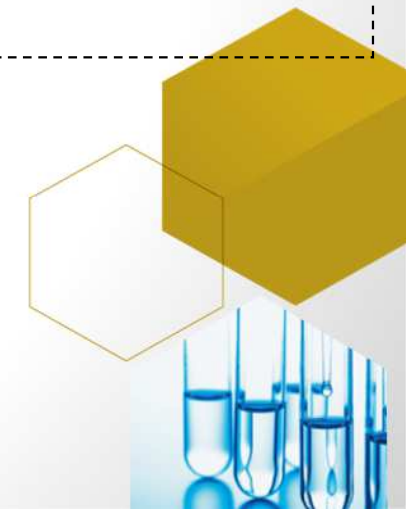
2023年7月24日





決算の概況

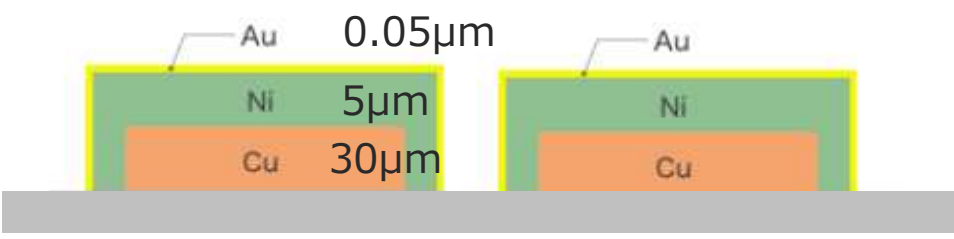
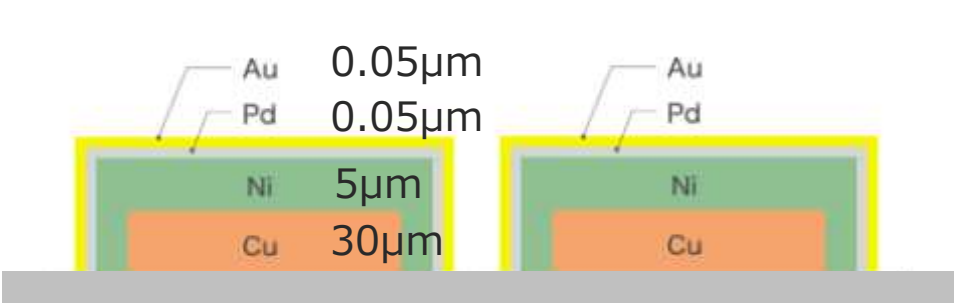
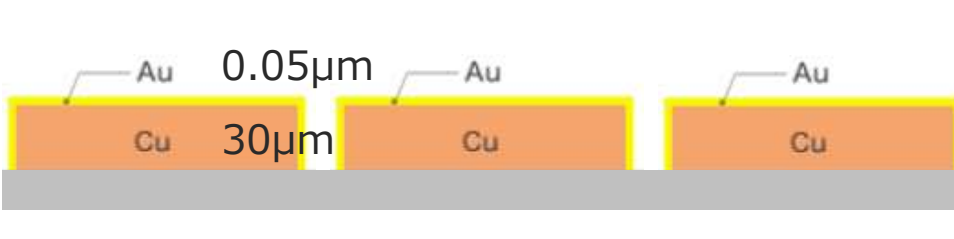
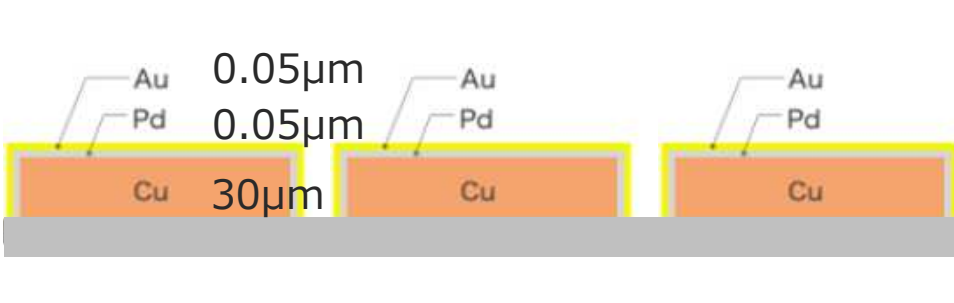
(注) 当社業績の見方のポイント

- ▶ 売上高は、薬品と一緒に貴金属を販売する場合と、薬品のみを販売する場合とで大きく変動します。
 - ▶ 貴金属は、価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。
- 
- 

用語説明①（めっき方式）

用語	用途	説明
電解めっき （電気めっき）	—	金属などの表面に電気を流してめっきする方法
純金めっき	プリント基板 半導体搭載基板	高純度な純金めっき
硬質金めっき	コネクタ プリント基板	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウム （Pd）めっき	リードフレーム コネクタ	金めっきの下地めっきとして使用される
無電解めっき	—	電気を流さず化学反応によりめっきする方法
置換めっき	プリント基板	金属ごとの溶けやすさ（イオン化傾向）を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元めっき	プリント基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法

用語説明② (めっきプロセス)

用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Immersion Goldの略 層構成はCu-Ni-Au	
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略 層構成はCu-Ni-Pd-Au	
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Direct Immersion Goldの略 Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。層構成はCu-Au	
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Palladium Immersion Goldの略 層構成はCu-Pd-Au	

製品ラインアップ ～ラインアップ拡充と新分野開拓～

めっき方式		用途	製品ラインアップ	
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき	
	硬質金 (合金)		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき	オーロブライト BAR7
	パラジウム(Pd)		PPF用薄膜パラジウムめっき (PPF: Pre Plated Lead frame)	パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき ニッケル不使用置換金めっき	IM-GOLD IB2X IM-GOLD CN IM-GOLD PC
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき	HY-GOLD HY-GOLD CN
	還元Pd		ENEPIG用還元パラジウムめっき ニッケル不使用還元パラジウムめっき	ネオパラブライト 2 ネオパラブライト DP
周辺分野			卑金属（銅、スズ、ニッケル） 合金めっき 後処理剤など	

2024年3月期 第1四半期決算概況

電子部品業界の状況

- 世界的な金利上昇や原材料高騰に伴う景気減速の影響により、ミドルレンジスマートフォンやパソコンなど民生向けの需要が低迷
- クラウド/データセンター向けや半導体装置などの産業機器向けにおいては投資に慎重な姿勢が見られ、低調に推移
- 車載用電子部品については、半導体不足の緩和と自動車の電装化や電気自動車へのシフトに伴う最終製品1台あたりの搭載数増加による需要増から、コロナ前の水準にはまだ戻っていないものの底を脱して復調の兆し

当社決算の概況

- プリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品
最先端半導体パッケージ向けなどで堅調な需要が見られたものの、スマートフォンやパソコン向け、およびこれらのメモリ向けで需要が低迷
- コネクター用めっき薬品
他社との技術的優位性から産業機器向けで堅調に推移したものの、スマートフォン向けの需要減を補うには至らず
- リードフレーム用めっき薬品
スマートフォンやパソコン向けの需要低迷とパラジウム価格下落の影響を受けて減収

2024年3月期 第1四半期決算概況

(単位：百万円、%)

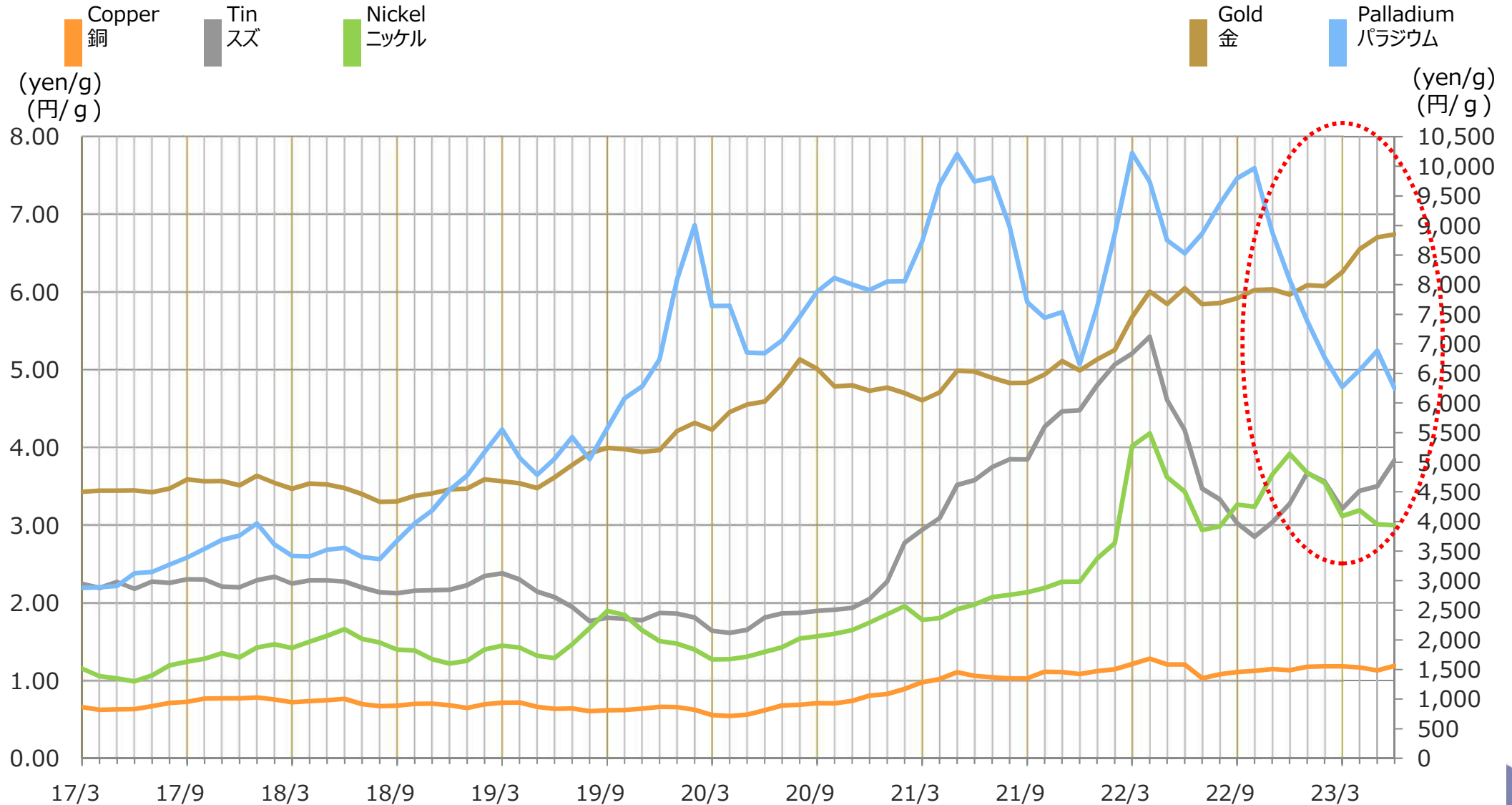
	2023/3期 1Q	2024/3期		2024/3期予想	
		1Q	増減率		第1四半期 達成率
売上高	5,050	2,843	△43.7	16,500	17.2
営業利益	282	54	△80.6	700	7.8
経常利益	374	154	△58.9	850	18.1
四半期純利益	278	119	△57.1	600	19.9
1株当たり 四半期純利益	47.52円	20.74円	—	104.33円	—

- 需要が旺盛であった2023年3月期第1四半期と比較し、主力のメモリ用途のプリント基板及びコネクタ向けの出荷減の影響が大きく、前期比大幅な減収減益

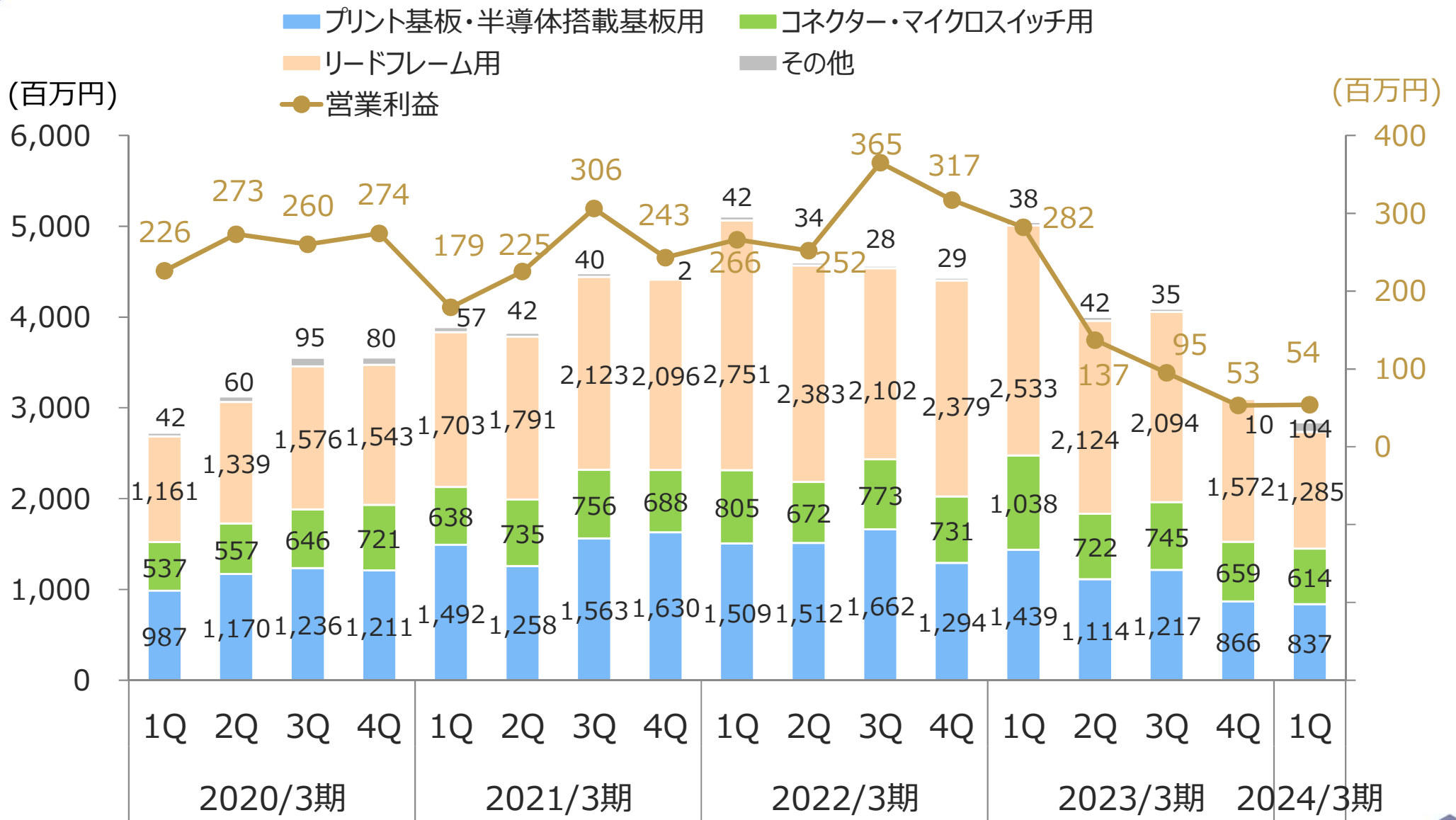
メタル相場推移

Prices of copper, tin and nickel
銅、スズ、ニッケル価格

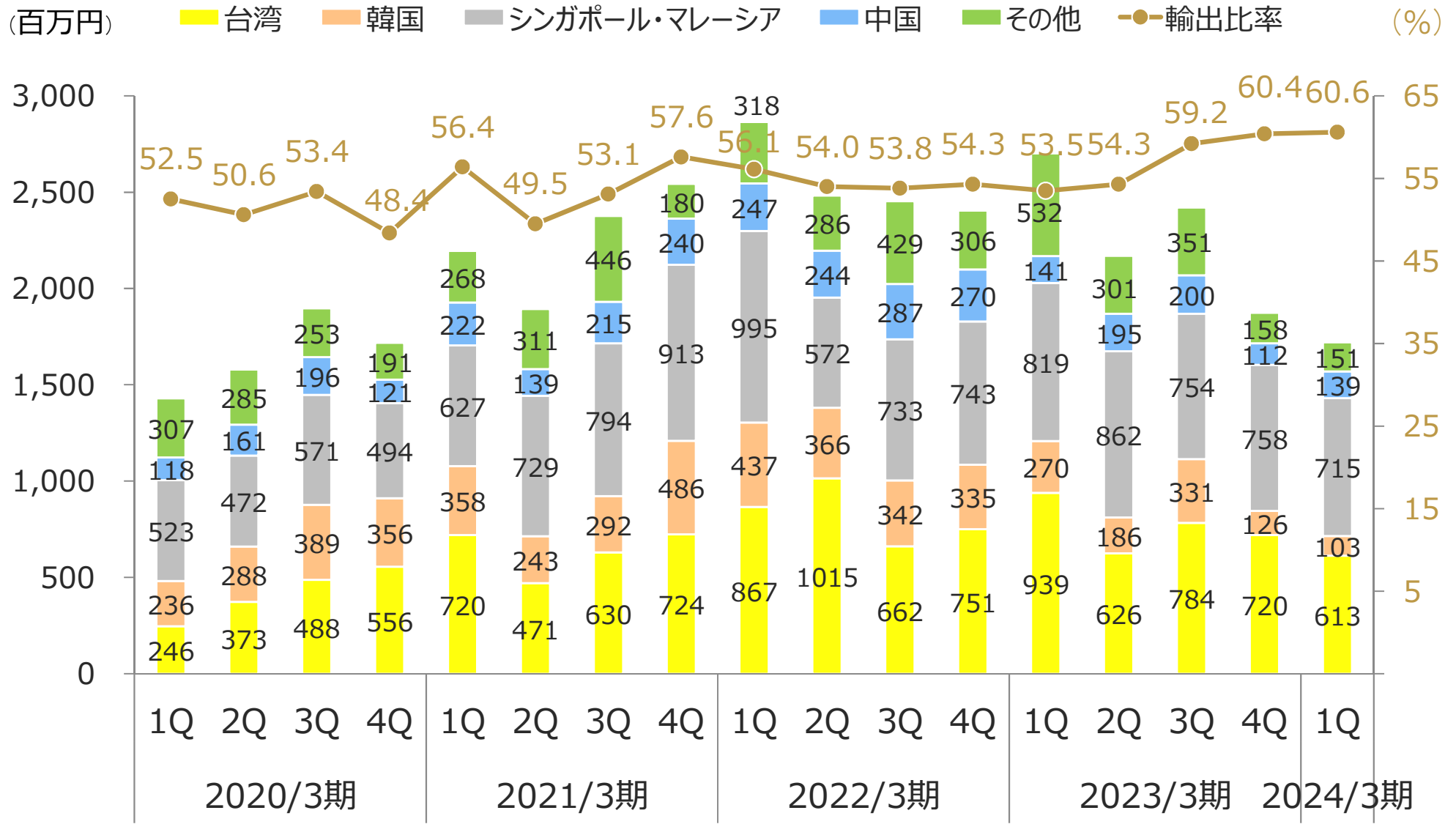
Prices of gold and palladium
金、パラジウム価格



売上高・営業利益の推移（四半期ベース）



輸出地域別売上高の推移（四半期ベース）



2024年3月期 通期の見通し

(単位：百万円、%)

	2023/3期		2024/3期	
		前期比増減		前期比増減
売上高	16,254	△13.1	16,500	1.5
営業利益	567	△52.8	700	23.3
経常利益	753	△43.7	850	12.8
当期純利益	569	△41.5	600	5.3
配当	80円		80円	

- 消費低迷や投資抑制の影響により、2Qも引き続き電子部品の需要は低調に推移することが予想されるものの、一部顧客で回復基調も見られ、スマートフォン、産業機器、データセンター関連の需要は緩やかに回復するものと期待され、プリント基板・半導体搭載基板用、車載コネクタ用、およびリードフレーム用めっき薬品の期後半からの需要回復を見込む
- 通期の見通しは、下期の需要回復を見込み、期初予想を据え置き



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2023年6月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>

補足資料： 会社紹介

沿革

- 1971年 7月 会社設立
- 1999年 11月 MBOを実施
- 2002年 12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年 3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年 3月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年 2月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年 4月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年 4月 東京証券取引所プライム市場に移行

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献